

1934339-1 ✓ AKTIV

Z-PACK | Z-PACK TinMan

Interne TE-Nummer 1934339-1

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 90 Position,
Mating Alignment, Guide Slot Mating Alignment Type, 9 Row, 10
Column, Z-PACK TinMan

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **90**

Reihenabstand: **1.4 mm [.055 in]**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Führungsanschluss**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Backplane-Modultyp	Mitte
Signalanordnung	Differenzial
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Paare pro Spalte	3
Anzahl der Paare	30
Stapelbar	Nein
Anzahl der Signalpositionen	60
Anzahl von Positionen	90
Zeilenanzahl	9
Spaltenanzahl	10
Backplane-Architektur	Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite)
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal

Elektrische Kennwerte



UL-Nennspannung	250 VAC
Impedanz	100 Ω
Arbeitsspannung	250 VAC

Signalmerkmale

Differenzialimpedanz	100 Ω
Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	3
Datenrate	10 Gb/s

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	6 mm[.236 in]
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.5 μm[20 μin]
Kontakttyp	Stift
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm[29.92 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Rechteckig
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	2.5 mm[.098 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

Führungskomponenten	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Führungsanschluss
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Anzahl der gehüllten Seiten	Zweiseitig
-----------------------------	------------

Endwandposition	Öffnen
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	1.9 mm[.075 in]

Abmessungen

Steckverbinderlänge	19.15 mm
Steckverbinderhöhe	11.8 mm
Steckverbinderbreite	16 mm
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.47 mm
Reihenabstand	1.4 mm[.055 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Grad	Anerkannt
UL-Dateinummer	E28476
Behörde/Norm	UL
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube
--------------------	--

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

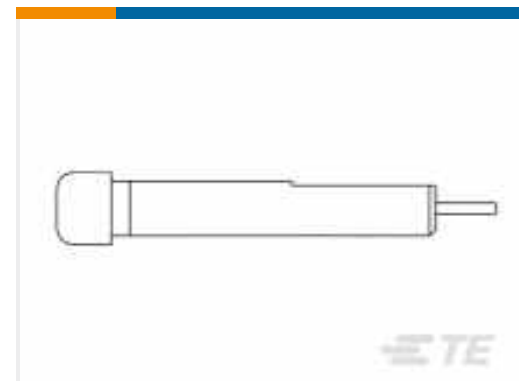
Kompatible Teile



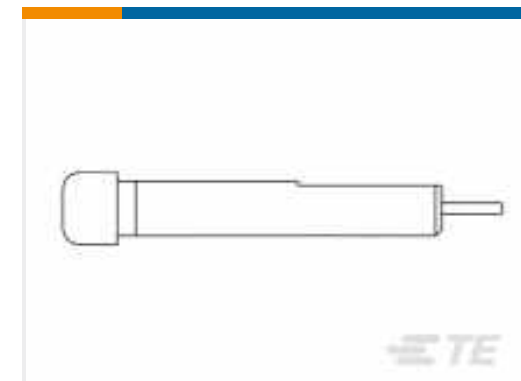
TE Teilnr.: 1934229-1
Tin Man Recept Assy 3 Pair 16 Column



TE Teilnr.: 1934228-1
Tin Man Recept Assy 3 pair 10 C



TE Teilnr.: 1976930-1
INS TOOL, TIN MAN, 4.5



TE Teilnr.: 1976935-1
EXT TOOL. IND CONTACTS, T.M.

Auch serienmäßig | Z-PACK TinMan

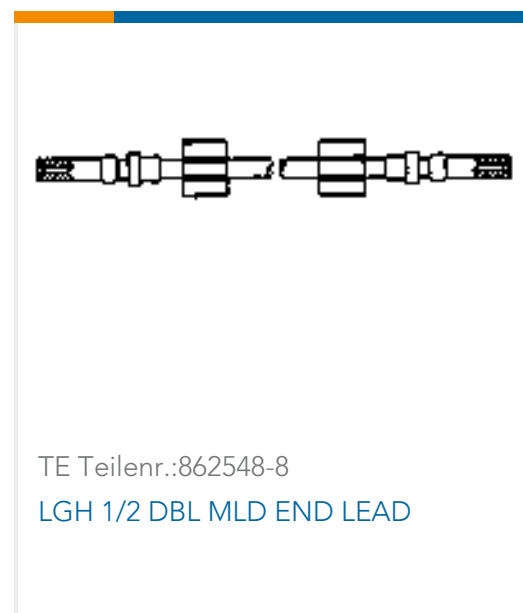
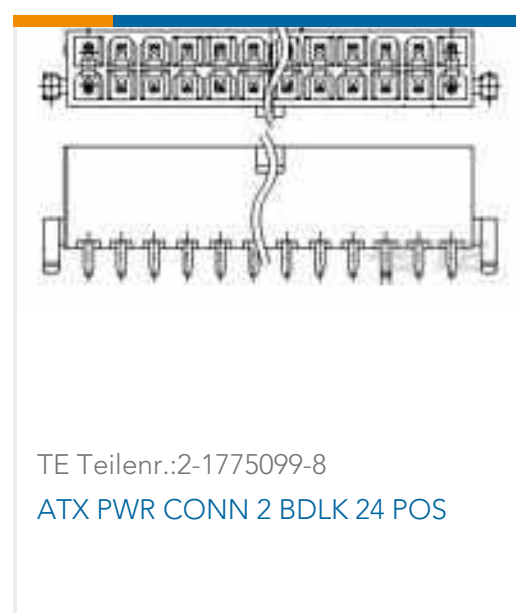
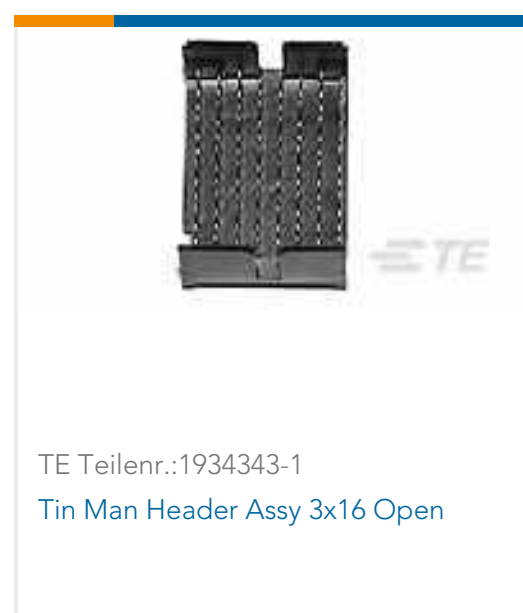
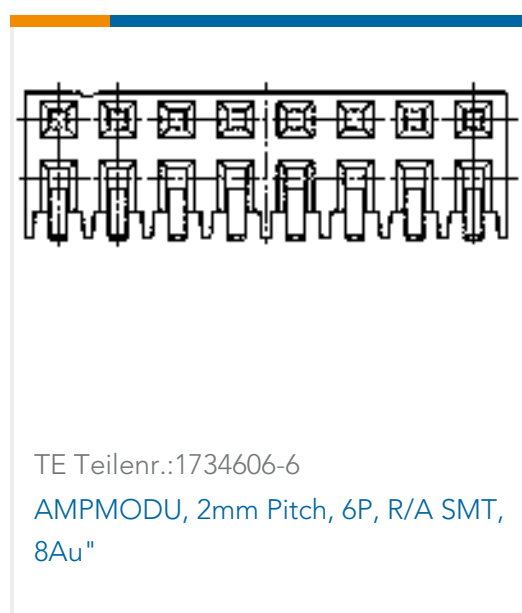


Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
(2)



Hochgeschwindigkeits-Backplane-
Steckverbinder(65)

Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

TinMan Header Assy 3x10 Open

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_1934339-1_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_1934339-1_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_1934339-1_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector

Englisch

Z-PACK TinMan High Speed High Density Backplane Connector Catalog 5-1773447-9

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

1934339-1

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 90 Position, Mating Alignment,
Guide Slot Mating Alignment Type, 9 Row, 10 Column, Z-PACK TinMan

